OBLEA MULTIPROYECTO Diseño y fabricación de circuitos integrados

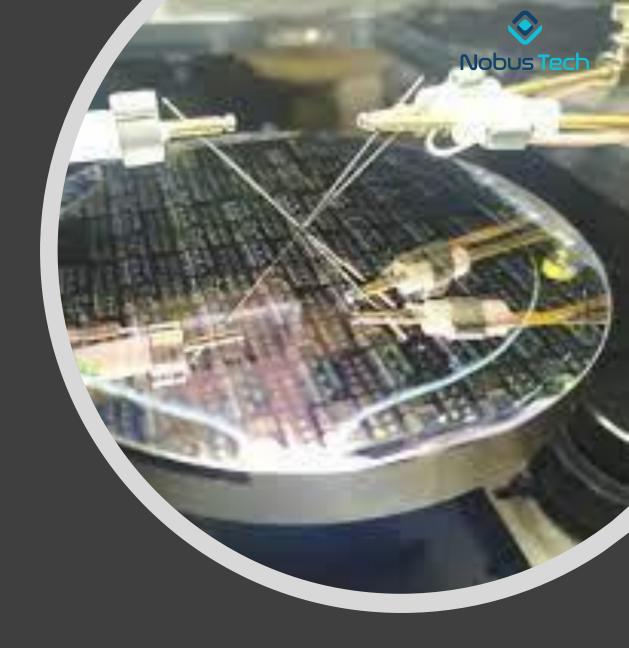


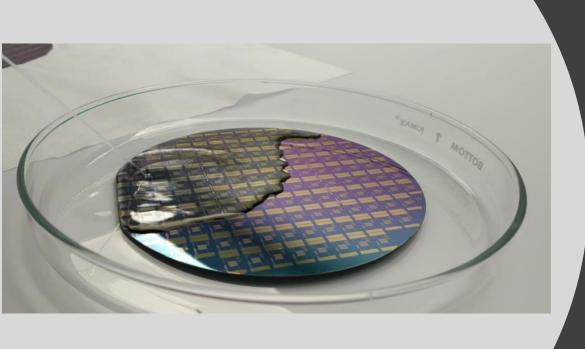




Objetivo

Consolidar procesos de fabricación de circuitos integrados que de soluciones de alto valor al sector industrial a nivel nacional con base en una plataforma tecnológica con procesos flexibles y enfocados al cliente.





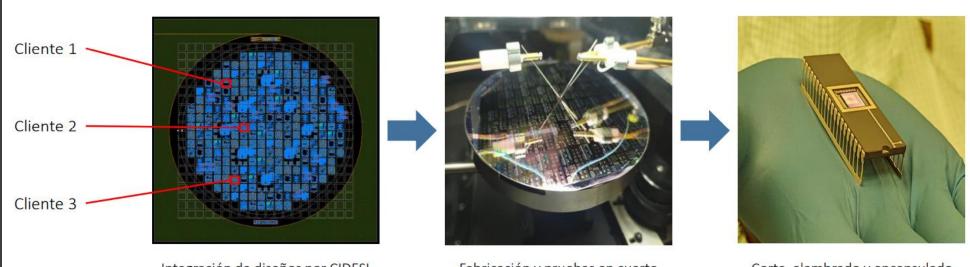


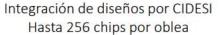
Características

- Tecnológica única en México.
- Combina diferentes diseños en una sola oblea, proporcionando ahorros a los clientes al compartir los costes de obleas y máscaras entre varios participantes.
- Abarca tecnologías de proceso de semiconductores analógicos, fabricación y otros servicios: NMOS y CMOS.
- Cuarto Limpio de 360 m².
- Servicio de desarrollo, diseño y acompañamiento por especialistas.

Propuesta Tecnológica y Comercial

- Entendimiento de las necesidades de Continental México
- Validación en CIDESI y cotización del servicio
- Aprobación de Continental
- Corrida Acceso a la plataforma, herramientas, acompañamiento, asesoría
- Entrega de Resultados Servicio y Soporte





Fabricación y pruebas en cuarto limpio de CIDESI

Fabricación de una oblea de 100 mm Chips: 256 (4x4 mm), 749 (2x2mm)

Corte, alambrado y encapsulado



Servicio Oblea Multiproyecto (SOMP)

- Implementación de herramientas de acceso libre para los clientes.
- Archivos de diseño para tecnología CIDESI_NM05.
- Manuales, tutoriales y seguimiento aforo de consulta.
- Plataforma web de vinculación y soporte

